

TGL-X-SI ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfähiger, hochviskoser und dispensierbarer Form-in-Place Gap-Filler mit dem sich gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Der fertige Compound erfordert keinen zusätzlichen Vernetzungsprozess. Durch die Formulierung und Füllung des Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine extrem hohe thermische Leitfähigkeit. Bei Aufbringung des dispensierbaren, viskoplastischen Materials wird ein optimaler thermischer Kontakt ohne Druckaufbringung erzielt. Durch seinen Einsatz wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert.



EIGENSCHAFTEN

- ☐ Dispensierbar
- ☐ Fast drucklose Aufbringung durch Viskoplastizität
- ☐ Wärmeleitfähigkeit: 6,5 W/mK
- ☐ Kein zusätzlicher Vernetzungsprozess

LIEFERFORMEN

- ☐ Kartuschen 50 ml, 300 ml, 5 kg
- ☐ Auf Anfrage

ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

- ☐ SMD Bauteilen
 - ☐ Through-hole Vias
 - ☐ RDRAM Speicherbausteine
 - ☐ Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
- z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer / 5G Telekommunikationsausrüstung

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TGL-X-SI
MATERIAL		
Farbe		Keramik gefüllter Silikoncompound Orange
Dichte	g/cm ³	3,4
Flußrate	g/s g/min	≥ 30 ¹ 3 – 4 ²
Penetration	mm	170
Haltbarkeit (ab Herstelldatum, ungeöffnet, trocken gelagert @ < 40°C)	Monate	6
Entflammbarkeit (Äquivalent)	UL 94	V0
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja
THERMISCH		
Thermische Leitfähigkeit ³	W/mK	6,5
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 150
ELEKTRISCH		
Durchschlagsfestigkeit ⁴	kV / mm	≥ 4,5
Durchgangswiderstand	Ohm - cm	1,0 x 10 ¹⁴

Prüfmethode in Anlehnung an: ¹ ISO 9048, ² 50 cc / 14# @ 0.42 MPa, ³ ASTM D 5470, ⁴ ASTM D 149. Typische, unverbindliche Richtwerte. Nicht für Spezifikationszwecke geeignet. Technische Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.